

浙江众合科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	线上投资者
时间	2026 年 8 月 25 日（周二） 下午 15:00-16:00
地点	同花顺路演平台
上市公司接待人员	副总裁兼董事会秘书 何俊丽 财务总监 王美娇
投资者关系活动主要内容介绍	回答投资者提问 问题 1: 一直在讲"低空经济", 具体落地的产品有哪些? 答: 公司在低空领域的业务主要覆盖低空无人飞行器的飞控系统和低空基础设施领域, 包括 UniTFCC 三余度飞控计算机、UniSpace 低空综合服务平台和 UniPort 智慧公共起降场管理平台。 问题 2: 公司是否有市值管理或股份回购计划? 对当前股价和估值水平有何看法? 答: 公司重视市值管理并严格遵守监管规定, 董事会已于 2025 年 8 月审议并通过了《市值管理制度》。公司目前暂无实施中的回购计划。未来, 公司在持续聚焦主营业务、提升经营效率的同时, 将综合运用包括股权激励、现金分红、股份回购、投资者关系管理、ESG 建设等多种方式, 着力提升公司的整体投资价值。 问题 3: 公司上半年营收增长, 亏损收窄的主要原因是什么? 答: 2026 年上半年, 公司实现营业收入 8.85 亿元, 同

	比增长 28.60%；归母净利润亏损 1,627.04 万元，较上年同期亏损 6,669.78 万元收窄 75.61%；扣除非经常性损益后的净利润亏损 4,675.85 万元，同比收窄 36.99%。亏损大幅收窄主要得益于智慧交通及半导体两大主业收入增长且整体毛利率上升；同时相关投资公允价值提升，形成非经常性损益，对当期利润产生积极影响。 问题 4: 金华工厂产能调试进度如何了？请问目前月产能、良率具体是多少？何时能达产？达产后对成本和利润的贡献如何？ 答: 金华工厂随着生产设备陆续到场并完成安装，产能正在持续增加，同时，产品良率稳步提升。根据当前设备安装调试进度及产能爬坡节奏，预计金华工厂 2027 年将实现达产。 问题 5: 泛半导体毛利率同比提升，请问主要来自产品调价还是成本下降？单晶硅价格当前处于什么周期位置？这波涨价能否持续？ 答: 公司在近年下行周期中不断优化自身工艺与产品结构，实现降本增效；产品调价的因素带来的毛利增长预计在下半年有所体现。目前市场行情向好，价格有望持续上涨。 问题 6: 董秘您好，公司互动平台此前提到海纳浦江基地送样产品已进入付费小批量试样采购阶段。请问目前是否已有客户转入批量供货？如果还没有，预计大致还需要多久？ 答: 随着供需关系调整，公司前期试样客户已开始逐渐快速上量，并且已与部分主要客户签订三年长单框架协议。
--	--

	议。
关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 说明	否
附件清单（如有，可 作为附件）	无